

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



## SUBMINIATURE ELECTRONIC DEVICE "Super Mini Mold" FOR SURFACE MOUNT

### INTRODUCTION

Conventional market needs for surface mount devices have been limited to such markets that require miniaturization, for example Hybrid IC's, electronic calculator, Clock and Camera market.

But nowadays, Demand for surface mount device is expanding in various markets in order to standardize the devices and improve production efficiency.

NEC catered to these needs in early stages and developed a surface mount device called "Mini Mold" 17 years ago. Since then, we have extended our line-up to the devices such as Power Mini Mold (SOT-89), MP-3 and 4-Pin Mini Mold.

Today, the number of used surface mount devices tends to increase, especially in new-coming high function sets. This trend also needs further miniaturization of surface mount devices. But this time, NEC added further miniaturized type of "Super Mini Mold", called to our line-up to give more satisfactory resolution and meet today's hot market needs for miniaturization.

This document presents general features and specifications of "Super Mini Mold" series.

### 1. FEATURES

"Super Mini Mold" series has following features.

(1) Light-weight, micronization

mounting square measure	: 60 % (of conventional "Mini Mold" package)
weight	: 50 % (of conventional "Mini Mold" package)

(2) Standard package

You can freely replace with the supplier's products because the products are designed based on standard outform, EIAJ: SC-70.

(3) Automatic mounting is possible

Automatic mounting by conventional automatic mounter for "Mini Mold" package is possible.

(4) Rich in line-up

You can freely find a device with features just you desire to design most suited circuit for your set, because most of features you can get from "Mini Mold" devices are also available from "Super Mini Mold" line-up because many of both type devices have common chips in.

In addition to that, you can switch "Mini Mold" devices to "Super Mini Mold" type, of course, as the characteristics remain unchanged.

NEC cannot assume any responsibility for any circuits shown or represent that they are free from patent infringement.

NEC reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design and supply the best product possible.

© NEC Corporation 1988

## 2. PACKAGE AND STRUCTURE

Fig. 1 PACKAGE (UNIT: mm)

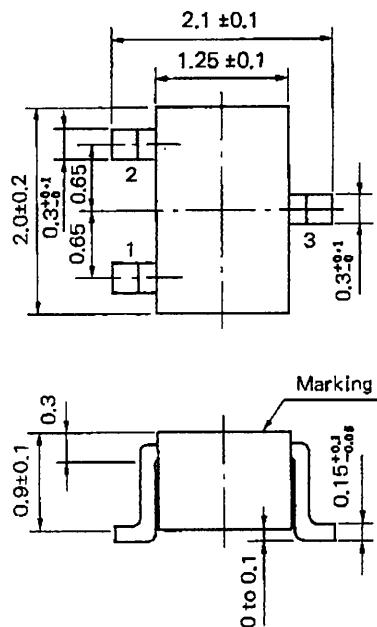
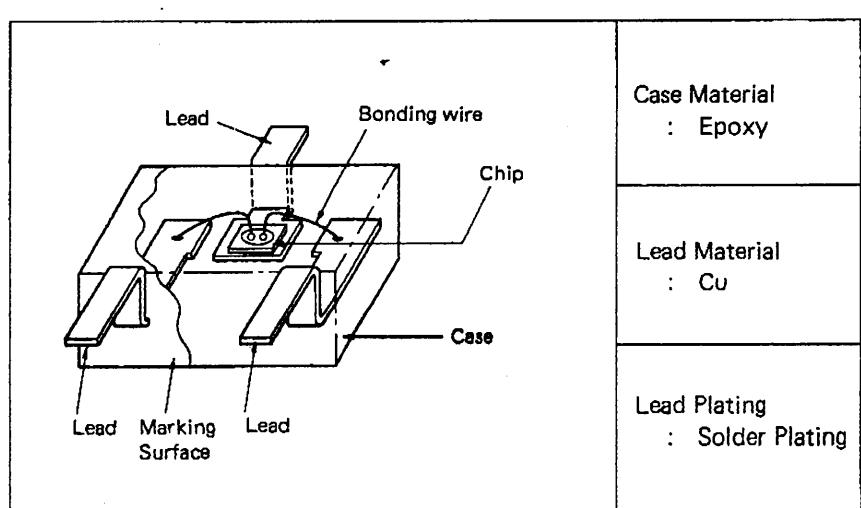


Fig. 2 STRUCTURE



## 3. POWER DISSIPATION AND THERMAL RESISTANCE

### 3.1 Power Dissipation Data with Substrates

Fig. 3  $P_T$  vs.  $T_a$  Characteristics with Alumina Ceramic Substrate (2SC4177 etc.)

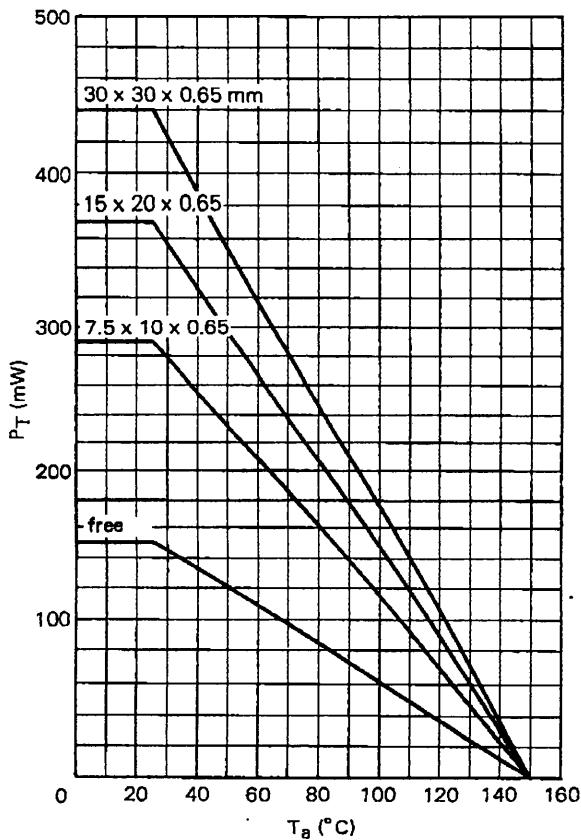
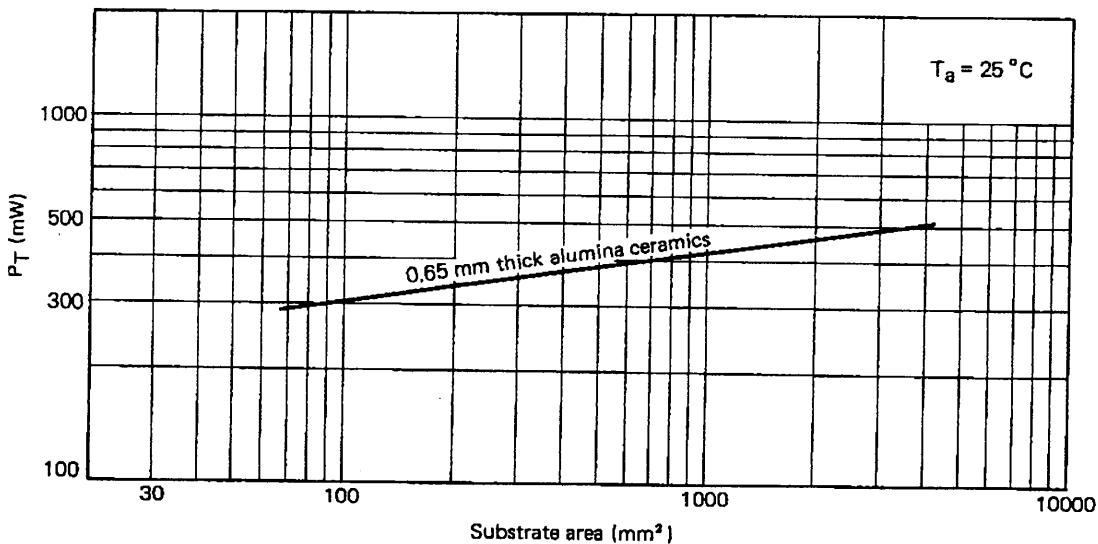


Fig. 4  $P_T$  vs. Substrate Size Characteristics



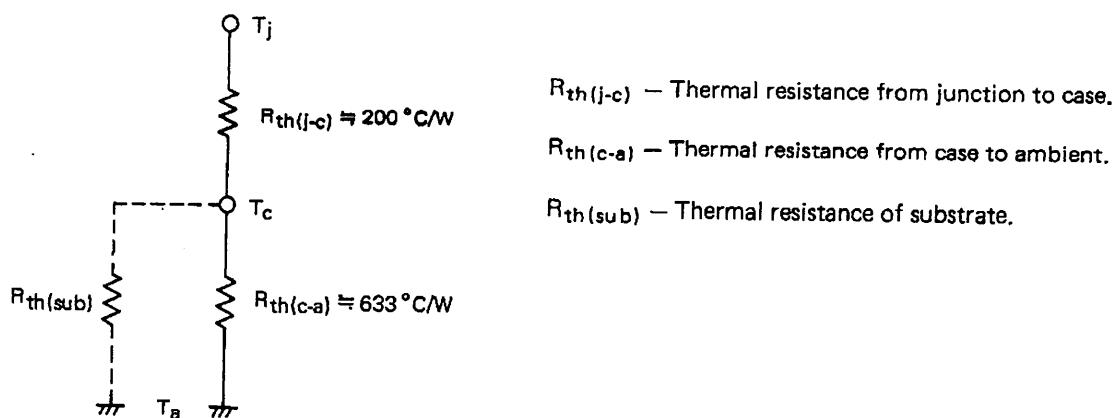
### 3.2 Thermal Resistance

- Total power dissipation  $P_T$  can be calculated according to the maximum junction temperature ( $T_{j\text{MAX.}}$ ), ambient temperature ( $T_a$ ) and thermal resistance.

$$P_T = \frac{T_{j\text{MAX.}} - T_a}{R_{th}}$$

- Thermal Resistance are as follows Fig. 5.

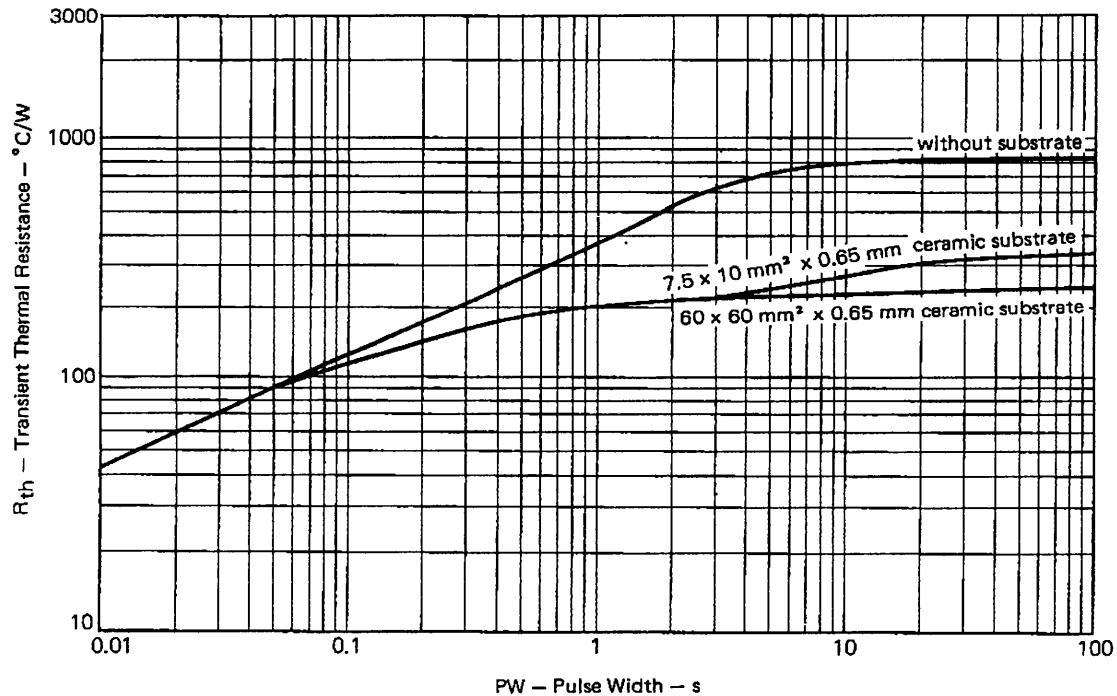
Fig. 5 Thermal Resistance



### 3.3 Transient Thermal Resistance

- When pulsed power supplied the device, Junction temperature must be calculated based on the transient thermal resistance.

Fig. 6 Transient Thermal Resistance (2SC4177)



### 4. MOUNT PAD AND EXAMPLE OF MOUNT

- MOUNT PAD

Fig. 7 Mount Pad

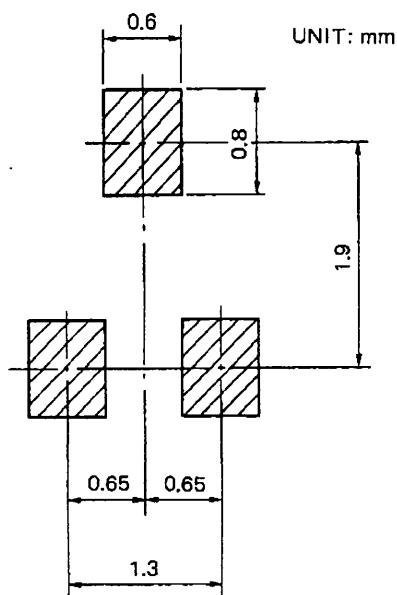
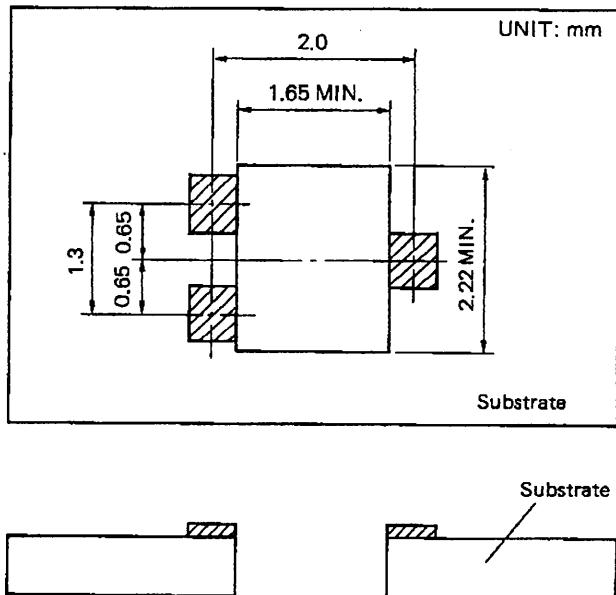
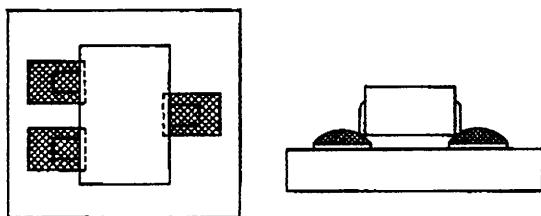


Fig. 8 Mount Pad in case of plugging Substrate

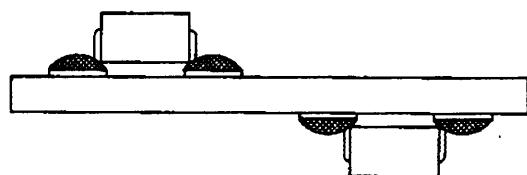


- Example of mounting

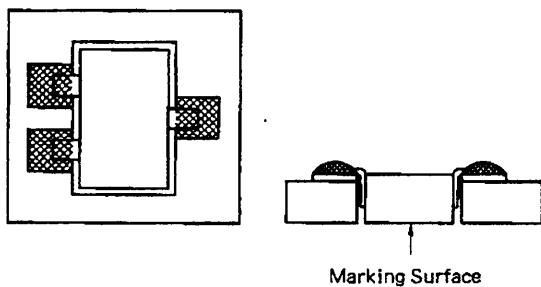
**Fig. 9 Example of mounting on one side.**



**Fig. 10 Example of mounting on both side.**



**Fig. 11 Example of plugging Substrate.**



---

**MEM-1011**  
**May 1988M**  
**Printed in Japan**